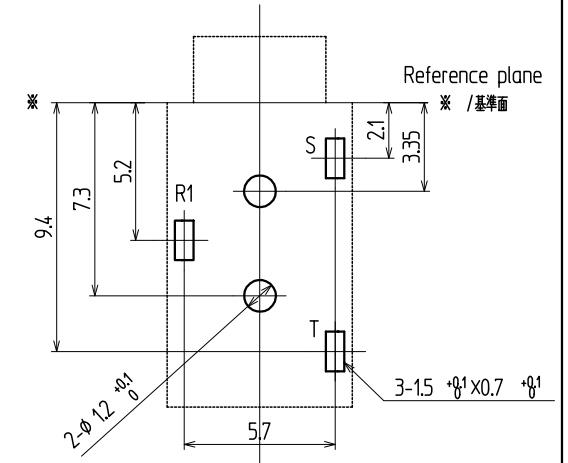
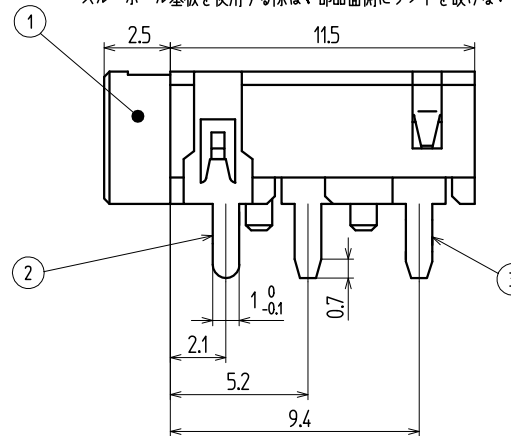


Note  
注記

1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.  
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様に注意して下さい。
2. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack into a soldering bath.  
半田槽にてディップする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じない様にして下さい。
3. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.  
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。



Note / 注3  
Referential dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view / パターン面) (Tolerance / 公差 ALL ±0.1, 1.2(S) = 2/1)

3.5 DIA LA4														
3	CONTACT コンタクト	2	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	10.25	(T,R1)								SILVER PLATED Agめっき	
2	EARTH CONTACT アースパネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	10.25	(S)								SILVER PLATED Agめっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PA66 G15% 黒							94V-0				
No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質			No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考					
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( )印は、参考寸法													ISSUED 出図	
APPROVED 責任者		CHECKED 照査者		DRAWN 製図者		DESIGNED 設計者		TITLE 名称		3.5 DIA PHONE JACK / 小形車頭ジャック			REVISION 版数	
								CODE No. コードNo.		YKB21-5298				
								UNIT 単位		DRAWING No. 図番				
								SCALE 尺度		PAGE ページ				
								CUSTOMER CODE ユーザーコード						

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.